

高精度フリップチップボンダー

ALPHA
DESIGN

HSB-300

ALPHA SOLUTION LINE-UP



3D積層実装・各種実装プロセス、
キャビティ構造基板にも対応可能な、
世界最高クラスの実装精度を実現した装置です

■ 特長

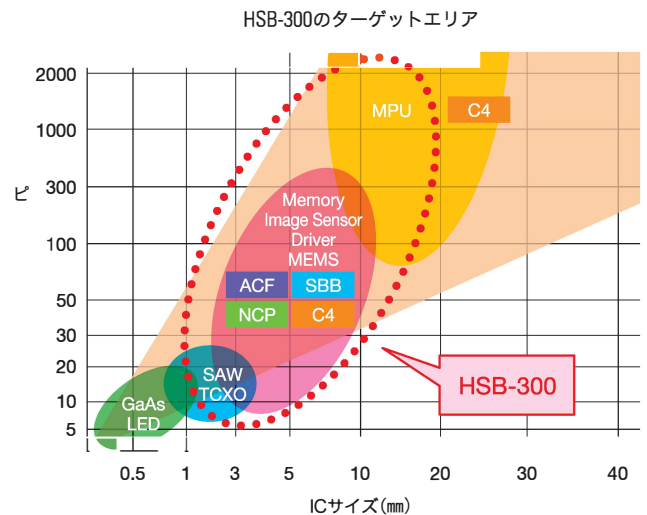


HSB-300

1. 高精度実装 $\pm 2\mu\text{m}/3\sigma$ を実現
2. 高スループット 1.6sec./chip を実現
3. 各種熱プロセスに対応可能
4. 超音波ヘッドに段取り替え可能

■ 標準仕様

機種名	高精度フリップチップボンダー	
型式	HSB-300	
対象基板サイズ	50×50mm~250×200mm t=0.5mm~2.5mm	
対象部品サイズ	□1mm~□15mm t=0.05mm~0.5mm(0.05mmは条件有り)	
装置サイズ	幅(W)1,350×奥行(D)1,820×高さ(H)1,550mm(*3色灯除く)	
重量	約1,600kg	
動力源	電源	3相 AC200V(50/60Hz)・単相 AC100V(50/60Hz)
	ドライエア	0.4MPa
	真空源	-80kPa
部品供給形態	ウエハー供給 8インチ、12インチ トレイ供給 2インチ、4インチ	
実装精度	$\pm 2\mu\text{m}/3\sigma$ (X, Y) ※弊社測定方法にて測定。	
実装サイクル時間	1.6sec./chip ※プロセス時間は除きます。	
加圧レンジ	0.5N~150N	
加熱レンジ	ヘッド 常温~Max. 450℃ ステージ: 常温~Max. 150℃	
オプション	□300基板対応	
	自動ツールチェンジ(最大4品種)	
	自動ノズルチェンジ(最大4品種)	
	ディスペンサーユニット	
	ウエハーマップ各種フォーマット対応	
	チップサイズ □26mm対応	



Au-Solder断面写真
bump pitch=50 μm
各種プロセス対応可能

※お客様の仕様に合わせてカスタマイズいたします。

アルファデザイン株式会社

〒389-0511 長野県東御市滋野甲2211-3
TEL 0268-64-0088 FAX 0268-64-0080
<http://www.alpha-design.co.jp/> seihi@alpha-design.co.jp

東京営業所 〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-41 TKB御殿山ビル
TEL 03-5656-9984 FAX 03-5656-9985
埼玉営業所 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町7-6ダイゴビル5F
TEL 049-293-2795 FAX 049-293-2796
宇都宮事業所 〒329-0524 栃木県河内郡上三川町多功2579-8
TEL 0285-38-7577 FAX 0285-38-7571
福岡営業所 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚5-11-1
TEL 092-612-1365 FAX 092-612-1366